

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年10月3日(03.10.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/203387 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/301 (2006.01) C09J 7/29 (2018.01)
C09J 7/22 (2018.01) C09J 7/38 (2018.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/009977
- (22) 国際出願日: 2024年3月14日(14.03.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-053186 2023年3月29日(29.03.2023) JP
- (71) 出願人: 古河電気工業株式会社(FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 山川 貴紀(YAMAKAWA, Takanori); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人クオリオ, 外(QUALIO IP ATTORNEYS et al.); 〒1050004 東京都港区新橋3丁目1番10号 石井ビル3階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,

LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

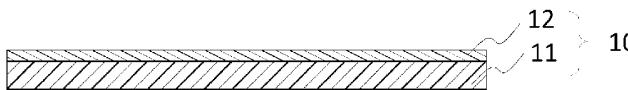
添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: PRESSURE-SENSITIVE ADHESIVE TAPE FOR DICING

(54) 発明の名称: ダイシング用粘着テープ

[図1]



(57) Abstract: Provided is a pressure-sensitive adhesive tape for dicing which comprises a substrate film and a pressure-sensitive adhesive layer formed thereon, wherein the substrate film has a melting point of 150°C or lower, the surface A of the substrate film on the reverse side from the pressure-sensitive adhesive layer has a surface roughness Ra of 0.10 μm or less, and the surface A has a needle penetration temperature of 80°C or higher.

(57) 要約: 基材フィルム上に粘着剤層を有するダイシング用粘着テープであって、前記基材フィルムの融点が150°C以下であり、前記基材フィルムの前記粘着剤層とは反対側の面Aの表面粗さRaが0.10 μm以下であり、この面Aの針入温度が80°C以上である、ダイシング用粘着テープ。

WO 2024/203387 A1